

2019-2025年中国LED封装行业市场前景预测及投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2019-2025年中国LED封装行业市场前景预测及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/442221.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

LED（半导体发光二极管）封装是指发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED封装简介

- 一、LED封装的概念
- 二、LED封装的形式
- 三、LED封装的结构类型
- 四、LED封装的工艺流程

第二节 LED封装的常见要素

- 一、LED引脚成形方法
- 二、LED弯脚及切脚
- 三、LED清洗
- 四、LED过流保护
- 五、LED焊接条件

第二章 LED封装产业总体发展分析

第一节 世界LED封装业的发展

- 一、发展概况
- 二、总体特征
- 三、区域分布

第二节 中国LED封装业的发展

- 一、发展现状
- 二、产值增长情况
- 三、产量增长情况
- 四、价格分析

五、利好因素

第三节 国内重要LED封装项目的建设进展

- 一、韩企投资扬州兴建LED封装基地
- 二、源力光电LED封装线正式投产
- 三、敬亭园中园LED支架及封装项目开建
- 四、TCL集团与台企合作建设LED封装厂
- 五、台企投建南昌高新区大功率LED封装项目
- 六、台湾连发光电LED封装项目落户铜陵
- 七、河南LED封装项目试制成功

第四节 SMD LED封装

- 一、SMD LED封装市场发展简况
- 二、SMD LED封装技术壁垒较高
- 三、SMD LED封装产能尚未过剩
- 四、SMD LED封装受益于芯片价格下降

第五节 LED封装业发展中存在的问题

- 一、制约我国LED封装业发展的因素
- 二、国内LED封装企业面临的挑战
- 三、封装业销售额与海外企业差距明显
- 四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈

第六节 促进中国LED封装业发展的策略

- 一、做大做强LED封装产业的对策
- 二、发展LED封装行业的措施建议
- 三、LED封装业发展需加大研发投入
- 四、我国LED封装业应向高端转型

第三章 中国LED封装市场格局分析

第一节 LED封装市场发展态势

- 一、中国成中低端LED封装重要基地
- 二、国内LED封装企业发展不平衡
- 三、中国LED封装市场缺乏大型企业
- 四、LED产业上游厂商涉足封装市场
- 五、台湾LED封装产能向大陆转移

第二节 LED封装企业发展格局

- 一、LED封装企业区域分布
- 二、LED封装企业加速上市

第三节 广东省LED封装业

- 一、主要特点
- 二、重点市场
- 三、发展趋势

第四节 LED封装市场竞争格局

- 一、中国采购影响世界封装市场格局
- 二、我国LED封装市场各方力量简述
- 三、国内LED封装市场竞争加剧
- 四、本土LED封装企业整合步伐加速

第五节 LED封装企业竞争力简析

- 一、本土封装企业竞争力排名
- 二、本土LED封装企业竞争力排名

第四章 LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中外LED封装技术的差异

- 一、封装生产及测试设备差异
- 二、LED芯片差异
- 三、封装辅助材料差异
- 四、封装设计差异
- 五、封装工艺差异
- 六、LED器件性能差异

第二节 中国LED封装技术发展概况

- 一、封装技术影响LED产品可靠性
- 二、中国LED业专利集中在封装领域
- 三、中国LED封装业的技术特点
- 四、LED封装技术水平不断提升
- 五、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

- 一、大功率LED封装的关键技术
- 二、显示屏用LED封装的技术要求
- 三、固态照明对LED封装的技术要求

第五章 LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

- 一、我国LED封装设备市场概况

- 二、LED封装设备国产化亟需加速
- 三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

- 一、LED封装主要原材介绍
- 二、我国LED封装材料市场简析
- 三、部分关键封装原材料仍依赖进口
- 四、LED封装用基板材料市场走向分析

第三节 LED封装支架市场

- 一、国内LED封装支架市场格局分析
- 二、LED封装支架技术未来发展趋势
- 三、我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 LED封装重点企业介绍

第一节 国外主要LED封装重点企业

- 一、科锐 (CREE)
- 二、日亚化学 (NICHIA)
- 三、飞利浦 (Philips)
- 四、三星LED (Samsung LED)
- 五、首尔半导体 (SSC)

第二节 中国台湾主要LED封装重点企业

- 一、亿光电子
- 二、光宝集团
- 三、东贝光电
- 四、宏齐科技
- 五、台积电
- 六、艾笛森

第三节 中国内地主要LED封装重点企业

- 一、国星光电
- 二、雷曼光电
- 三、鸿利光电
- 四、大族光电
- 五、瑞丰光电
- 六、升谱光电
- 七、木林森

第七章 2019-2025年中国LED封装产业发展趋势及前景

第一节 2019-2025年LED封装产业发展趋势

- 一、功率型白光LED封装技术发展趋势
- 二、LED封装技术将向模块化方向发展
- 三、LED封装产业未来发展走向分析

第二节 2019-2025年中国LED封装市场前景展望

- 一、我国LED封装市场发展前景乐观
- 二、LED封装产品应用市场将持续扩张
- 三、中国LED通用照明封装市场规模预测

第八章 2019-2025年中国LED封装行业发展趋势预测分析

第一节 2019-2025年中国LED封装行业前景展望

- 一、LED封装的研究进展及趋势分析
- 二、LED封装价格趋势分析

第二节 2019-2025年中国LED封装行业市场预测分析

- 一、LED封装市场供给预测分析
- 二、LED封装需求预测分析
- 三、LED封装竞争格局预测分析

第三节 2019-2025年中国LED封装行业市场盈利预测分析

第九章 2019-2025年中国LED封装行业投资和风险预警分析

第一节 2019-2025年LED封装行业发展环境分析

第二节 2019-2025年LED封装行业投资特性分析

- 一、2019-2025年中国LED封装行业进入壁垒
- 二、2019-2025年中国LED封装所属行业盈利模式
- 三、2019-2025年中国LED封装所属行业盈利因素

第三节 2019-2025年LED封装行业投资风险分析

- 一、2019-2025年中国LED封装行业政策风险
- 二、2019-2025年中国LED封装行业技术风险
- 三、2019-2025年中国LED封装行业供求风险
- 四、2019-2025年中国LED封装行业其它风险

第四节 2019-2025年中国LED封装行业投资机会

- 一、2019-2025年中国LED封装行业最新投资动向
- 二、2019-2025年中国LED封装行业投资机会分析

第五节 2019-2025年中国LED封装行业主要投资建议

图表目录：

图表：LED产品封装结构的类型

图表：全球前十大封装厂商营业收入情况

图表：全球前十大封装厂商市场占有情况

图表：全球主要LED封装企业的技术特色

图表：我国LED封装产业产值及增长情况

图表：我国LED封装产量及增长情况

图表：国内LED封装价格比较

图表：台湾、大陆主要SMD LED企业产能对比

图表：2018年中国LED各应用领域产值分布情况

图表：中国LED通用照明封装市场规模增长情况预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/442221.html>